

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年9月11日(2014.9.11)

【公開番号】特開2012-69928(P2012-69928A)

【公開日】平成24年4月5日(2012.4.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-014

【出願番号】特願2011-180658(P2011-180658)

【国際特許分類】

H 01 L 21/56 (2006.01)

H 01 L 23/29 (2006.01)

H 01 L 23/31 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/56 E

H 01 L 23/30 D

【手続補正書】

【提出日】平成26年7月28日(2014.7.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に、長さX(Xは5mm以下)の端子部と素子部とを形成し、

前記素子部上に、前記素子部を覆うように段差層を形成し、

前記段差層上に、前記素子部を覆うように可撓性を有する保護部材を設置し、

前記保護部材と、張り合わせ部材とを押し当てることで、前記保護部材を前記段差層に接着させ、

前記断層の厚さは、0.38X以上2mm以下であり、

前記張り合わせ部材は、表面硬度は50以上100以下の弾性材料であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

基板上に、長さX(Xは5mm以下)の端子部と素子部とを形成し、

前記素子部上に、前記素子部を覆うように段差層を形成し、

前記段差層上に、前記素子部を覆うように可撓性を有する保護部材を設置し、

前記保護部材と、張り合わせ部材とを押し当てることで、前記保護部材を前記段差層に溶着させ、

前記断層の厚さは、0.38X以上2mm以下であり、

前記張り合わせ部材は、表面硬度は50以上100以下の弾性材料であることを特徴とする半導体装置の作製方法。